

**INFORME DE VALORACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA CONTENIDA EN EL SOBRE 2  
CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA  
DEFINICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DISEÑO DE LA SALA BLANCA DEL  
PROYECTO INNOFAB PARA EL INSTITUT CATALÀ DE NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA  
(ICN2)**

**Expediente núm. 2025-24 ICN2**

Habiéndose establecido como fecha y hora límite de presentación de las proposiciones el día 15 de julio de 2025, a las 12:00 horas, se deja constancia de que, tal y como consta recogido en el acta de constitución de la Mesa de contratación y calificación de la documentación general contenida en el sobre núm. 1, se ha recibido oferta de una empresa, siendo ésta la siguiente:

**INDUSTRY CONSULTING Strobl GmbH & Co. KG**

El 22 de julio de 2025 a las 10:30 horas, se reunió la Mesa de Contratación para proceder a la apertura del sobre núm. 2, que contiene la documentación relativa a la propuesta técnica, según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Particulares, dejando constancia de la apertura en la correspondiente acta.

Habiéndose revisado por parte de los miembros de la Mesa la documentación, se dio traslado de las referidas propuestas a la persona técnica evaluadora de las ofertas, para confeccionar la correspondiente evaluación, de conformidad con los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego de Cláusulas Particulares y, en concreto, en el anexo 3.

**VALORACIONES DE LAS OFERTAS**

A continuación, se inicia la valoración de la oferta de la empresa **INDUSTRY CONSULTING Strobl GmbH & Co. KG**.

**1) B.3. Memoria técnica de prestación del servicio:**

La memoria entregada por la empresa **INDUSTRY CONSULTING Strobl GmbH & Co. KG** es técnicamente muy completa, explicando en detalle todos los aspectos técnicos relacionados con el proyecto.

El documento presentado tienes varios bloques, cada uno de ellos relacionado con aspectos técnicos o/y organizativos del servicio.

El primero de ellos *“Correlation Between Equipment Layout and Tool Utility Matrix”* describe el principio de diseño de una sala blanca, y la interrelación entre los equipos de producción y la llamada *“tool utility matrix”* (TUM), y como es necesaria una coordinación entre ambas actuaciones de diseño para asegurar una planificación coherente y sin errores, así como un uso eficiente de la infraestructura.

El segundo y el tercer bloque *“Methodology for Creating an Equipment Layout in the FAB and Subfab”* y *“Methodology for Creating a Tool Utility Matrix for a Semiconductor*



*Factory* “ presentan un enfoque integral y técnicamente sólido para la planificación del *layout* de equipos en fábricas de semiconductores. El desarrollo del *layout* integra listas de equipos validadas, especificaciones técnicas y requisitos de proceso para generar diseños 2D optimizados por zonas, compatibles con modelos BIM y las restricciones de infraestructura. Paralelamente, la *Tool Utility Matrix* (TUM) recopila todas las demandas de utilidades por equipo, utilizando datos de fabricantes y experiencia en procesos, aplicando factores de simultaneidad para un perfil de carga preciso. Ambas metodologías enfatizan la validación interdisciplinaria, la adaptabilidad y la revisión iterativa con el cliente. En conjunto, la propuesta de ambas metodologías asegura una integración coherente de equipos, utilidades e infraestructura, permitiendo una planificación de fábricas eficiente, escalable y conforme a normativas.

El cuarto bloque “*Risk Management for Tool Layout and TUM*” propone un enfoque para la gestión de riesgos en la planificación del *layout* de equipos y la *Tool Utility Matrix* (TUM). Este enfoque es técnicamente muy sólido, abordando de forma proactiva factores de riesgo comunes —como requisitos incompletos, falta de alineación interdisciplinaria y cambios tardíos— mediante estrategias de mitigación bien estructuradas. La participación temprana de las partes interesadas garantiza una recopilación integral de requisitos, mientras que el uso de plantillas estandarizadas para la TUM fomentará la coherencia y minimiza omisiones. Los ciclos de revisión periódicos y las simulaciones con herramientas de *layout* evidencian un fuerte compromiso con la validación iterativa y la mejora continua. La inclusión de un proceso formal de gestión de cambios refuerza aún más la solidez del enfoque, y es muy adecuado para proyectos complejos en fábricas de semiconductores.

Finalmente, el quinto bloque “*Project Timeline*” presenta una planificación temporal muy detallada de todo el proyecto y el proceso para su ejecución, incluyendo duración de actividades, su definición, la información necesaria en cada momento, y cuáles son los entregables de cada actividad.

En general, la propuesta es muy completa y demuestra un alto nivel de rigor técnico y aplicabilidad práctica. Integra metodologías comprobadas, coordinación interdisciplinaria y estrategias de mitigación de riesgos, constituyendo una base sólida y escalable para la planificación de fábricas de semiconductores. Su enfoque estructurado garantiza coherencia, adaptabilidad y alineación con buenas prácticas.

Si bien el contenido técnico del documento es excelente, es importante resaltar que a nivel formal la propuesta carece de una presentación adecuada ya que no dispone de índice, logos o firma.

Bellaterra, 23 de julio de 2025

Fdo. Jose A Garrido

**ICREA Research Professor and Group Leader of  
Advanced Electronic Materials and Devices**

